

# 큐엠씨

## KONEX [136660]

2021.06.04.

본 자료는 한국거래소의 코넥스 기업분석보고서 발간지원사업(KONEX Research Project)에 따라 작성된 보고서입니다.

### Mini & Micro LED 장비 제조 전문기업

(주)NICE 디앤비 박정연 연구원  
konex@nicednb.com

#### 기업정보(2021-06-03 기준)

대표자	유병소
설립일자	2003-07-29
상장일자	2014-07-01
기업규모	중소기업
업종분류	특수 목적용 기계 제조업
주요제품	LED, 반도체, 카메라 모듈 제조 및 검사 장비 등

#### 시세정보(2021-06-03 기준)

현재주가	3,955 원
액면가	500 원
시가총액	374 억원
총 발행주식수	9,443,800 주
52주 최고주가	6,200 원
최저주가	3,300 원
외국인지분율	-
주요주주	
유병소	35.27%
(2021-03-29 기준)	

#### ▣ 디스플레이 및 반도체 공정장비를 제조하기 위한 자체기술을 확보

큐엠씨(이하 동사)는 LED 장비, 반도체 장비, 카메라 모듈 장비 개발 및 제조를 주요 사업을 영위하고 있으며, 장비 제작을 위한 레이저/광학 기술, 고속정밀 이송 기술, 측정 및 검사 기술, 자동화 제어 기술 총 4가지의 핵심기술을 확보하고 있다. 동사는 핵심기술을 기반으로 다양한 칩 사이즈에 대응 가능한 장비 설계, 레이저 빔 경로 설계, 레이저 파장 제어, 정밀 스테이지 제어, 레이저 핸들링, 전기적 및 광학적 특성 측정 정밀도 향상 등 공정장비 구현에 대한 연구를 거듭하며 고객사 제품 특성에 따른 공정장비를 개발 및 생산하고 있다.

#### ▣ 차세대 디스플레이 장비 개발로 새로운 성장 기회 모색 중

세계 디스플레이 장비 시장은 전반적으로 다소 어두운 시황을 보이고 있으나, 국내 디스플레이 장비 시장은 LCD 시장이 축소되고 OLED 시장이 활성화되면서, 국내 점유율이 높은 국내 OLED 장비 제조업체의 수요 증가 등의 요인이 시장 성장을 견인할 것으로 전망된다. 또한, 동사를 포함한 디스플레이 장비 전문기업은 Mini LED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 장비 개발 본격화를 통해 침체된 디스플레이 장비 산업의 위기에서 새로운 성장 기회를 모색하고 있다.

#### ▣ Mini LED 장비, CMOS 이미지 센서 패키지 장비 등 신사업 아이템 발굴로 성장 동력 마련

동사는 전방 산업의 수요에 따른 경기변동이 크고, 다양한 성능 및 기능을 만족시키기 위한 급속한 기술혁신이 요구되는 반도체 및 디스플레이 산업에서 외형 성장 및 재도약을 위해 차세대 디스플레이인 Mini & Micro LED 장비, CMOS 이미지 센서 패키지 장비 등 신사업 아이템을 지속적으로 발굴하며 성장 동력을 마련하고 있다.

결산기	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2018A	375.7	-31.1	56.2	14.9	22.5	6.0	14.2	-6.5	69.8	238	2,491	24.3	2.3
2019A	52.7	-86.0	-82.6	-156.7	-85.3	-161.7	-44.1	-20.4	187.4	-903	2,093	-	1.7
2020A	150.3	185.1	-27.7	-18.4	-24.5	-16.3	-17.6	-5.8	220.1	-259	1,838	-	2.7

# 큐엠씨

KONEX [136660]

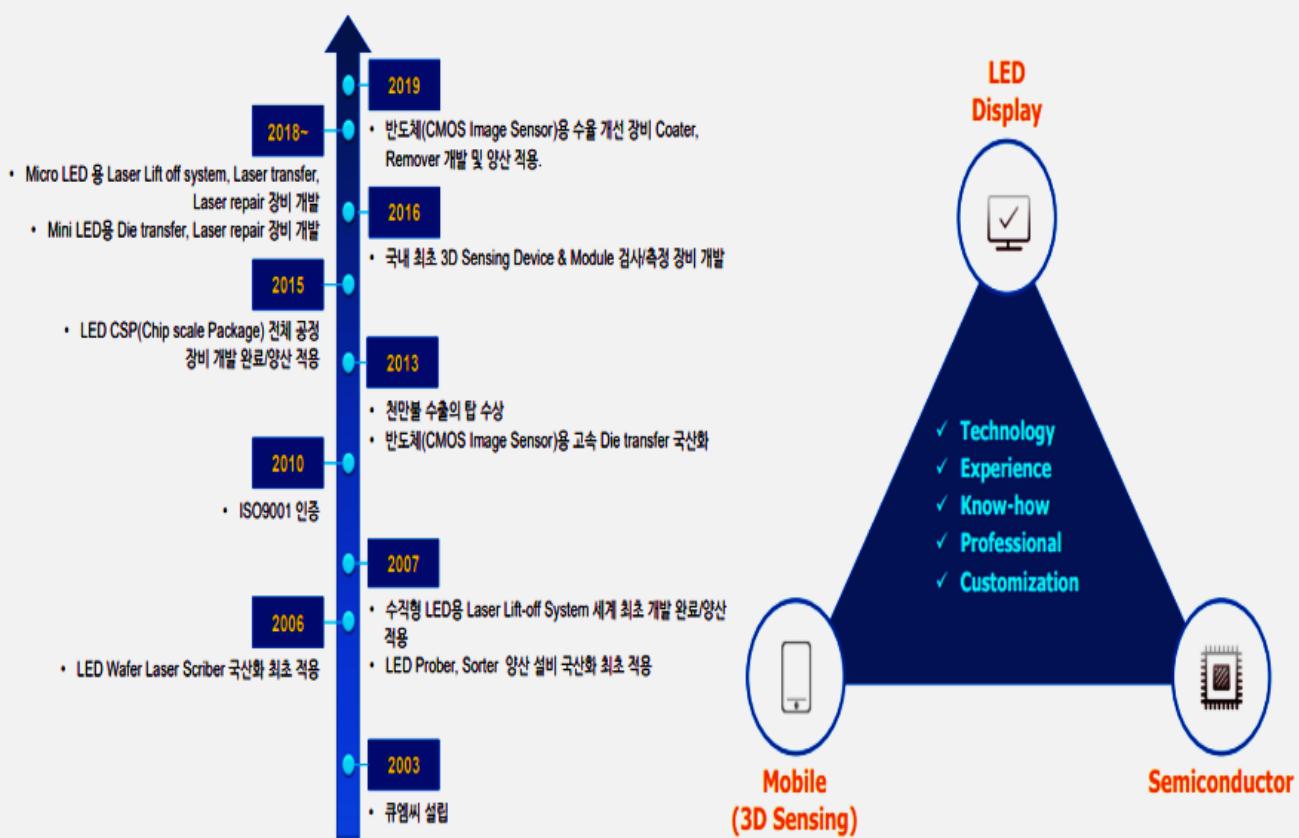
2021.06.04.

본 자료는 한국거래소의 코넥스 기업분석보고서 발간지원사업(KONEX Research Project)에 따라 작성된 보고서입니다.

## [기업개요]

동사는 2003년 7월 설립된 LED 장비, 반도체 장비, 카메라 모듈 장비 개발 및 제조 전문기업으로, 2014년 7월 코넥스 시장에 상장되었다. 동사는 경기도 안양시에 본사 및 생산공장을 두고 있으며, 생산공장 내부에 장비 개발 및 제조를 위한 설비와 실험용 자산을 구축하고 있다. 동사의 주요제품이 속하는 디스플레이 및 반도체 장비 산업은 주문자 생산방식을 채택하고 있으며, 동사는 고객사의 수요에 따른 다양한 장비를 개발 및 제조하고 있다. 동사는 핵심기술로 레이저/광학 기술, 고속정밀 이송 기술, 측정 및 검사 기술, 자동화 제어 기술을 확보하고 있으며, 핵심기술을 기반으로 Mini LED 칩 이송 장비, Micro LED 칩 분리 장비, 불량 화소 리페어 장비, 카메라 모듈 3D센싱 검사장비 등 다양한 장비를 개발하여 사업 다각화를 추진하고 있다.

## [주요 사업 및 연혁]



## LED, 반도체 제조용 장비 생산에 주력

동사는 2003년 7월 설립된 LED 장비, 반도체 장비, 카메라 모듈 장비 개발 및 제조 전문기업으로, 레이저/광학 기술, 고속정밀 이송 기술, 측정 및 검사 기술, 자동화 제어 기술 총 4가지의 핵심기술을 기반으로 Mini LED 칩 이송 장비, Micro LED 칩 전사 장비, 불량 화소 리페어 장비, 카메라 모듈 3D센싱 검사장비 등 각 제품군별 제조공정에 특화된 장비를 제조하고 있다.

동사는 2005년 4월 설립된 공인 기업부설연구소 내에 레이저/광학/생산기술 연구실을 운영하고 있으며, LED, 반도체 제조 및 카메라 모듈 검사를 위한 장비 개발을 수행하며 신규 제품 라인업을 확보하고 있다.

**표 1>> 동사의 제품 라인업**

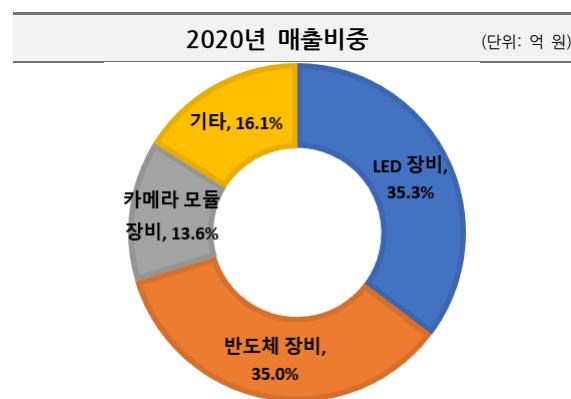
Industry	Device	Process Name			
		Laser Processing	Probing (Test)	Transfer & Sorting	etc.
Display	Mini LED		LCP series (Prober)	MDT series (Transfer)	SLR Series (Laser Repair)
	Micro LED	SLO series; (Laser Lift Off System)		Laser Transfer	SLR Series (Laser Repair)
CCM (3D Sensing)	VCSEL(SL)		VCT series (Prober & Sorter)	VPS series (Sorter)	
	ToF		ToF series	VPS series	SLM series (Laser marking)
Semiconductor	CMOS			DT series (Transfer)	Spin Coater Spin Remover
LED	Chip LED	SLO series; SLS series (Laser Scriber)	LCP series	LCS series (Sorter)	
	SMD LED		LPH series (Prober & Sorter)	LTM series (Taping machine)	SLM series
	CSP LED		LCP series	DT series LCS series LTM series	LPC series (Coating)

자료: 동사 IR 자료(2020), NICE디앤비 재가공

동사의 2020년 사업부문별 매출 비중을 살펴보면, 동사의 주력 매출원은 Mini & Micro LED 장비(35.3%)이며, 그 뒤를 이어, 반도체 장비(35.0%), 카메라 모듈 장비(13.6%), 기타(16.1%)로 구성되어 있다.

**표 2>> 동사의 제품 종류 및 2020년 매출 비중**

제품군	
Mini & Micro LED 장비	LED 레이저 절단, 박리, 디스펜싱 등의 공정장비, 디스플레이용 칩 분리, 전사, 리페어 장비 등
반도체 장비	CMOS 이미지 센싱용 칩 전사, Coater, Remover 등 관련 장비
카메라 모듈 장비	카메라 모듈 관련 장비, 자동차 및 기타 장비 등
기타	LED/반도체/기타 장비 등 제조공정상 부품 및 서비스



자료: 동사 사업보고서(2020.12), NICE디앤비 재가공

동사의 최근 3년 평균 내수 매출 비중은 79.3%로, 수출보다 내수 비중이 높은 편이다. 동사는 주요 고객사로 국내 LED, 반도체 전방 업체인 삼성전기, LG전자, LG이노텍 등을 확보하고 있으며, 사업 영역 다각화를 위해 LED, 반도체 글로벌 전방 업체를 대상으로 판매처 구축을 진행하고 있다. 동사의 수출 매출은 2018년 37.2억 원의 규모에서 미·중 무역분쟁 등의 요인으로 고객사의 설비투자가 위축되면서 2019년 17.1억 원 규모로 축소되었으나, Mini LED, Micro LED 등의 차세대 디스플레이와 카메라 모듈 설비투자가 진행되면서 2020년 29.3억 원 규모로 다시 성장하였다.

표 3 &gt; 동사의 매출 비중

(단위: 억 원, %)

구분	2018년	비중	2019년	비중	2020년	비중
내수	338.3	90.1	35.5	67.4	121.0	80.5
수출	37.3	9.9	17.2	32.6	29.3	19.5
매출총계	375.6	100.0	52.7	100.0	150.3	100.0

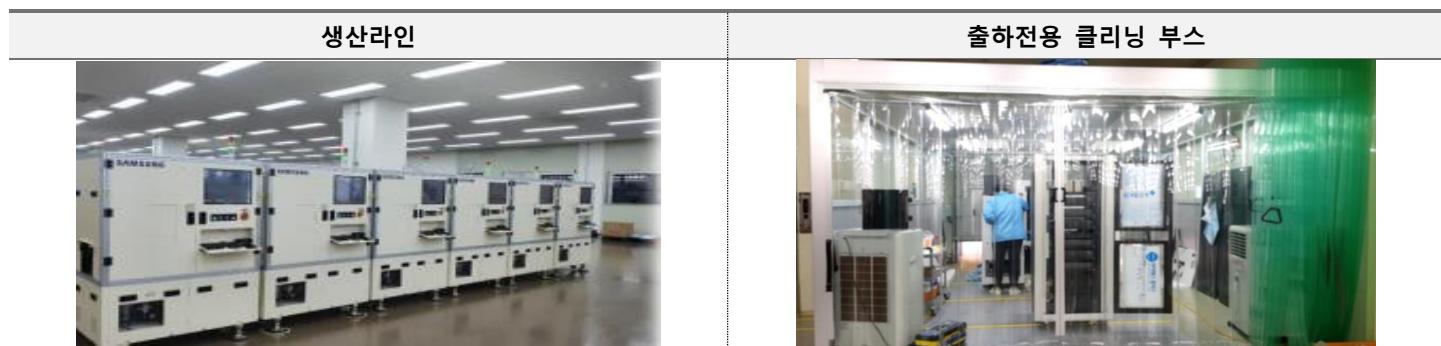
자료: 동사 사업보고서(2020.12), NICE디앤비 재가공

### 공정장비 개발에 특화된 핵심기술력 및 대규모 수주에 대응 가능한 생산능력 확보

동사는 공정장비 개발에 특화된 기술력을 바탕으로 공정장비 전문기업으로 성장하였다. 동사는 레이저/광학 기술, 고속정밀 이송 기술, 측정 및 검사 기술, 자동화 제어 기술 총 4가지의 핵심기술을 기반으로 고객사에서 제조하는 제품 특성에 따른 공정장비를 개발 및 생산하고 있다. 특히 동사는 다양한 칩 사이즈에 대응 가능한 장비 설계, 레이저 빔 경로 설계, 레이저 파장 제어, 정밀 스테이지 제어, 레이저 핸들링, 전기적 및 광학적 특성 측정 정밀도 향상 등 공정장비 구현에 대한 연구를 거듭하며 제품을 개발하고 있다. 동사의 핵심기술을 기반으로 개발된 레이저 응용 공정장비는 레이저 소스 빔의 경로 및 파장 제어가 가능하도록 설계되어 공정 정밀도를 높였다. 또한, LED 전사장비는 레이저 전사 방식을 적용하여 10um까지 고속으로 전사(초당 평균 2,000개)가 가능하고, 기계적 방식으로 60um까지 고속으로 전사(초당 평균 18개)가 가능하여 고객사의 생산 효율을 향상시키고 있다.

한편, 동사는 2019년 완공된 신사옥(경기도 안양시) 내부에 최대 200대 동시 생산 및 제조가 가능한 생산설비를 확보하고 있으며, 작업장 내에 항온, 항습 관리를 위해 세미 클린룸과 출하설비 전용 클리닝 부스(1,000Class)를 운영하고 있다.

그림 1 &gt; 동사의 생산시설



자료: 동사 IR 자료(2020), NICE디앤비 재가공

## Mini & Micro LED 장비, CMOS 이미지 센싱 패키지 장비 등 성장 동력 확보

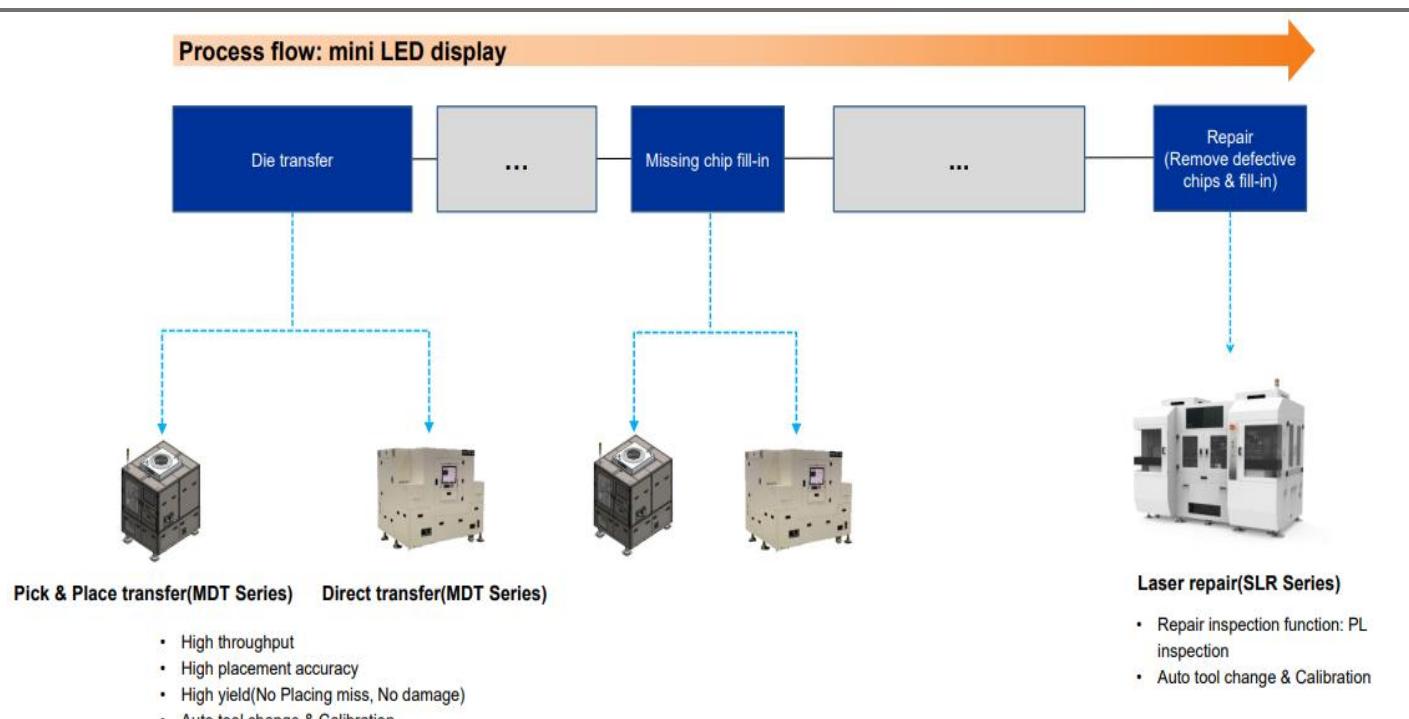
동사의 주요 제품이 속하는 반도체 및 디스플레이 장비 산업은 전방 산업의 수요에 따른 경기변동이 크고, 다양한 성능 및 기능을 만족시키기 위한 급속한 기술혁신이 요구되는 산업이다. 이에, 동사는 차세대 디스플레이인 Mini LED 장비, Micro LED 장비, CMOS 이미지 센서 패키지 장비 등의 신사업 아이템을 지속적으로 발굴하며 성장 동력을 마련하고 있다.

### ▶▶ Mini LED 장비

Mini LED는 칩의 사이즈를 기존 300~2,000um에서 100~200um 수준으로 작게 제작되는 소형 LED를 말하며, 기존 LED 대비 명암비 및 소비전력을 효율적으로 개선하여 차세대 디스플레이로 각광받고 있다. Mini LED는 기존 LCD, LED 생산라인을 대부분 활용할 수 있기 때문에 설비투자 부담이 없는 편이다. 이러한 장점으로 인해, 최근 삼성전자는 2021년에 Mini LED TV 약 200~300 만대를 출하하는 것을 목표로 첫 신제품 출시를 준비 중이다. 이러한 기술 트렌드에 따라, 동사는 2019년 차세대 디스플레이인 Mini LED용 칩 이송 장비, 레이저 리페어 장비 개발을 완료하였으며, 고객사에 납품하여 매출을 시현하고 있다.

동사가 개발한 Mini LED용 칩 이송 장비는 LED 칩을 디스플레이 기판으로 이송 또는 실장하는 장비로, 칩 역삼 및 오삽입 검출이 가능한 특징이 있다. Mini LED의 경우, 기존 LED보다 크기가 작아 세밀한 기계 제어기술이 요구되는데, 동사는 정밀 스테이지 제어기술과 이송 툴 포스 제어기술을 활용해 기존 LED 장비 대비 기계제어의 정밀도를 향상시켰다. 한편, 동사의 Mini LED용 레이저 리페어 장비는 점등검사가 완료된 디스플레이 기판의 불량 칩을 제거하고 실장하여 수리하는 장비로 레이저 빔 경로를 직접 설계하여 정확도를 향상시킨 특징이 있다.

**그림 2>> Mini LED 장비 종류**



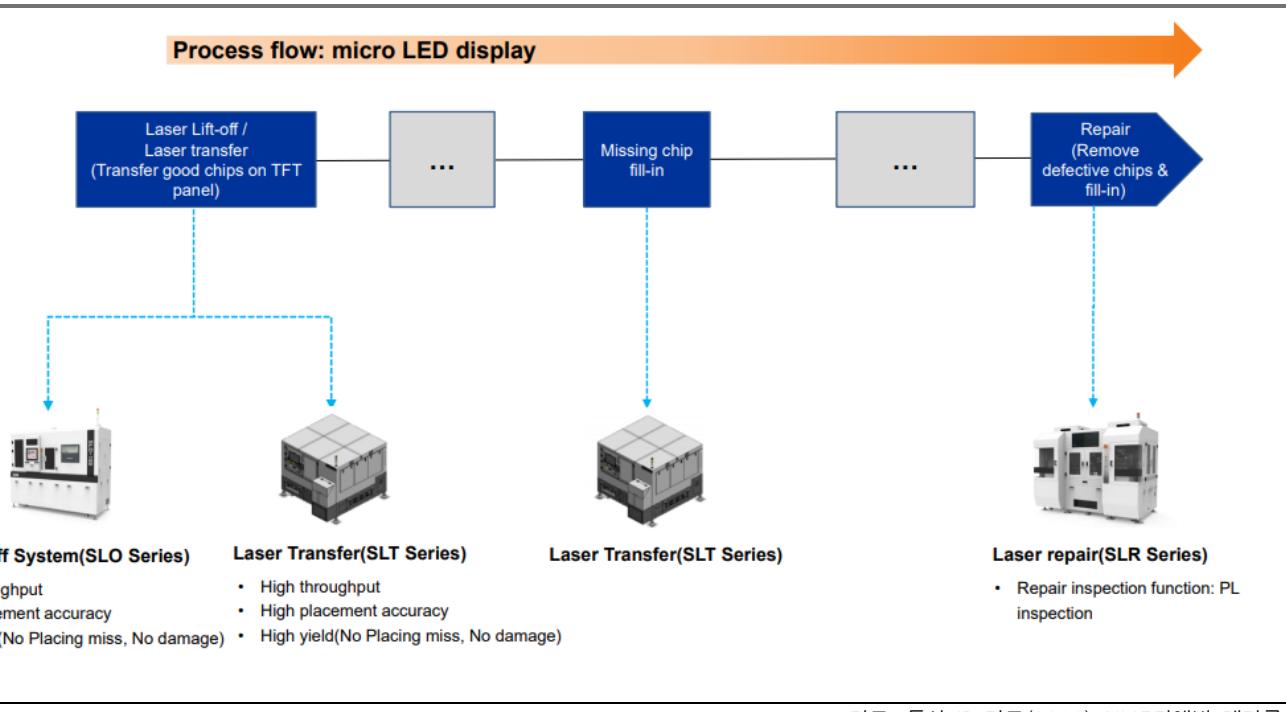
자료: 동사 IR 자료(2020), NICE디앤비 재가공

## ▶▶ Micro LED 장비

Micro LED는 칩의 사이즈를 기준 300~2,000um에서 1~100um 수준으로 작게 제작되는 초소형 LED를 말하며, 저전력화, 소형화, 경량화가 필요한 모든 광 응용 분야에 적용이 가능하다. 또한, LED 칩을 수십 마이크로 수준으로 작게 제작하여 무기물 재료의 특성상 휘어질 때 깨지는 단점을 극복할 수 있으며, 유연한 기판에 LED 칩을 전사함으로써 유연성을 부여하여 플렉시블 디스플레이, 섬유와 LED가 결합한 스마트 섬유, 인체부착 및 삽입형 의료기기, 바이오 컨텍트 렌즈, HMD 및 무선통신 분야에까지 광범위하게 활용 가능하다. 이러한 Micro LED를 다양한 응용 분야에 적용하기 위해서는 유연소재 및 소자를 기반으로 하는 맞춤형 Micro LED 칩 개발이 필수적이고, Micro LED 개별 또는 어레이된 칩들을 유연한 기판에 전사하는 공정기술 개발이 필요하며, 100um 이하의 불량칩을 자동으로 검출하고 수리하는 기술이 개발되어야 한다. 동사는 이러한 기술 트렌드에 따라, Micro LED용 레이저 Lift Off 시스템, 레이저 이송, 레이저 리페어 장비 개발을 완료하였으며, 2020년 6월 고객사에 납품하여 매출을 시현 중이다.

동사의 Micro LED용 레이저 Lift off 시스템은 LED 웨이퍼에서 이송기판으로 칩을 전사하는 장비로, 레이저 빔 경로를 자체 설계하여 셋업 및 선택적 레이저 lift Off가 가능하도록 구성하여 서비스 범위가 넓고 자유로운 특징이 있다. Micro LED용 레이저 이송 장비는 레이저를 이용하여 LED 칩을 디스플레이 기판으로 전사하는 장비로, DPSS(Diode-Pumped Solid-state Laser) 레이저를 사용하여 효율적인 코스를 제공하고, 빔의 경로를 자체 설계하여 셋업 및 서비스 범위가 넓고 자유로운 특징이 있다. 또한, 동사의 Micro LED용 레이저 리페어 장비는 점등검사가 완료된 디스플레이 기판의 불량 칩을 제거하고 정상 칩을 실장하여 디스플레이 기판을 수리하는 장비로 레이저 빔 경로를 직접 설계하여 정확도를 향상시킨 특징이 있다.

**그림 3>> Micro LED 장비 종류**



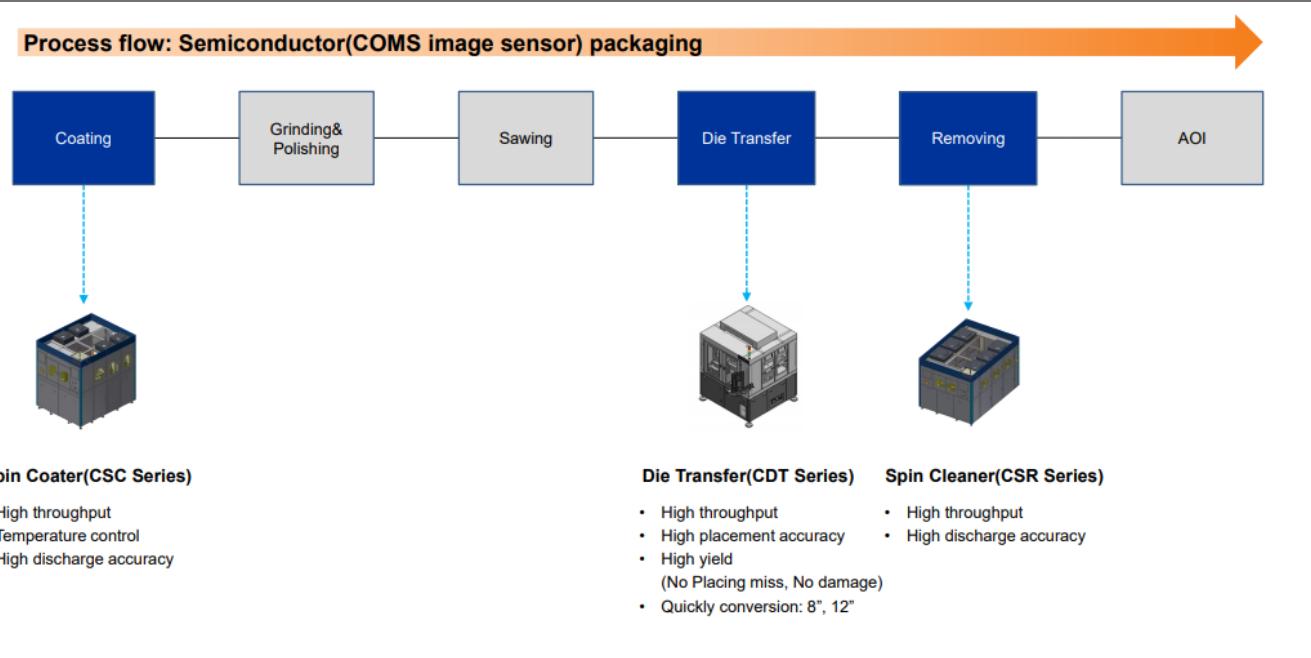
자료: 동사 IR 자료(2020), NICE디앤비 재가공

## ▶▶ CMOS 이미지 센서 패키징 장비

이미지 센서는 응용 방식과 제조 방식에 따라 CCD(Charge Coupled Device) 이미지 센서와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 이미지 센서로 분류되며, CCD 이미지 센서는 화질 및 감도가 우수해 고화질 디지털 카메라 등에 주로 사용되고, CMOS 이미지 센서는 전력 소모가 적고 집적도가 높아 가격이 낮은 장점으로 인해 최근 대부분 카메라 모듈에 채택되고 있다.

동사는 COMS 이미지 센서 패키징에 사용되는 이송 장비, 코팅 장비 및 제거 장비를 개발하였으며, 고객사에 납품하여 매출을 시현 중이다. 동사의 COMS 이미지 센서 패키징에 사용되는 이송 장비는 분리된 칩을 웨이퍼 형태로 공급받아 칩의 위치를 자동으로 스캔하고, 정해진 분류데이터를 기준으로 제품을 양불을 고속으로 분류하는 장비이다. COMS 이미지 센서 패키징에 사용되는 코팅 및 제거 장비는 반도체 웨이퍼를 연마하거나, 절삭할 때 발생되는 파티클을 통해 웨이퍼가 오염되는 것을 방지하기 위해 웨이퍼에 코팅하고, 절삭공정이 완료된 뒤 웨이퍼에 코팅된 보호물질을 제거하는 장비이다.

**그림 4>> Micro LED 장비 종류**



자료: 동사 IR 자료(2020), NICE디앤비 재가공

## 세계 디스플레이 장비 시장의 축소될 것으로 전망되나, 국내 디스플레이 장비 시장은 성장 전망

한국반도체디스플레이기술학회의 글로벌 반도체 및 디스플레이 장비 시장 동향 및 전망 자료(2020)에 따르면, 세계 디스플레이 장비 시장은 삼성디스플레이와 중화권 패널업체 중심으로 전체 설비 투자가 확대되면서, 2018년 141억 달러 규모에서 2020년 169억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되나, 2020년을 기점으로, 국내 및 중국의 패널업체들이 중소형 플렉시블 OLED 투자를 지속하고, LCD 투자를 축소할 것으로 예상되어, LCD 비중이 높았던 전체 디스플레이 장비 시장 규모가 서서히 축소되어 2024년에는 87억 달러 규모를 형성할 것으로 전망된다.

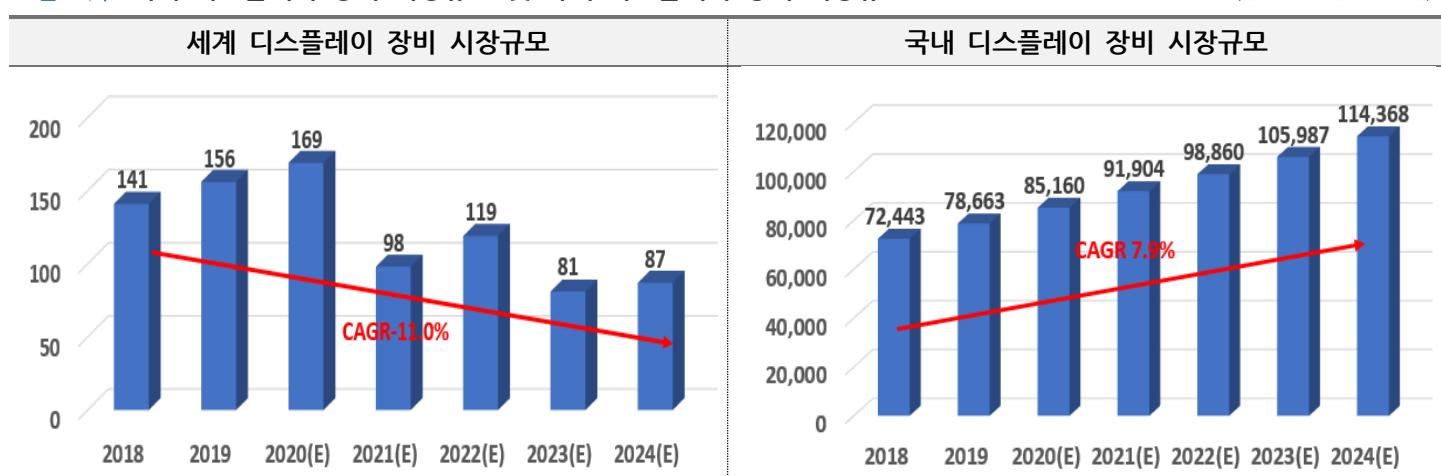
또한, 디스플레이 산업은 LCD 의 공급과잉 속에 투자 경쟁을 벌였던 중국 업체들이 최근 선별 투자에 나서면서 시장 규모가 급격히 축소하는 추세로 추가적인 설비투자가 지연되어 디스플레이 장비 시장의 축소가 전망된다.

한편, 중소벤처기업부의 중소기업 전략기술로드맵 보고서(2021~2023)에 따르면, 국내 디스플레이 장비 시장은 2018년 7조 2,443억 원 규모에서 연평균 7.91%로 성장하여 2024년에는 11조 4,368억 원의 시장규모를 형성할 것으로 전망된다. 세계 디스플레이 장비 시장은 전반적으로 다소 어두운 시황을 보이고 있으나, 국내 디스플레이 장비 시장은 LCD 시장이 축소되고 OLED 시장이 활성화되면서, 국내 점유율이 높은 국내 OLED 장비 제조업체의 성장이 전망된다.

또한, 동사를 포함한 디스플레이 장비 전문기업은 Mini LED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 장비 개발 본격화를 통해 침체된 디스플레이 장비 산업의 위기에서 새로운 성장 기회를 모색하고 있다.

**그림 5> 세계 디스플레이 장비 시장규모 및 국내 디스플레이 장비 시장규모**

(단위: 억 달러/억 원)



자료: 글로벌 반도체 및 디스플레이 장비 시장 동향 및 전망 자료(2020), 중소기업 전략기술로드맵 보고서(2021~2023), NICE디앤비 재가공

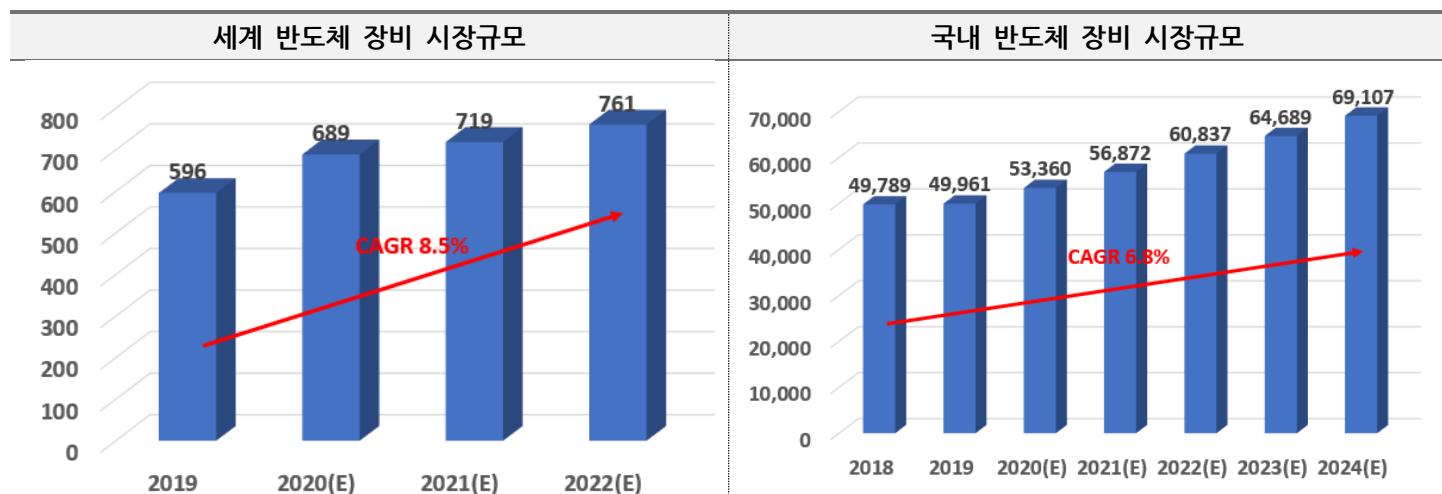
## 반도체 장비 시장 성장 전망

국제반도체장비재료협회(2020)에 따르면, 2020년 세계 반도체 장비 매출액은 2019년 596억 달러에서 약 16% 상승한 689억 달러 규모로 성장하고, 이 성장세는 지속되어 2021년에는 719억 달러, 2022년에는 761억 달러 규모를 형성할 것으로 전망된다. 세계 반도체 장비 시장은 중국이 파운드리와 메모리 분야에 대한 공격적인 투자로 전 세계 최대 반도체 장비 매출 지역이 될 것으로 보이며, 한국이 2021년과 2022년에는 메모리와 로직 반도체에 대한 투자로 인해 2년 연속 최대 반도체 장비 투자지역이 될 것으로 예상되며 대만은 파운드리에 대한 지속적인 강력한 투자를 이어나갈 것으로 예상된다.

또한, 중소벤처기업부의 중소기업 전략기술로드맵 보고서(2021~2023)에 따르면, 국내 반도체 장비 시장은 2018년 4조 9,789억 원 규모에서 연평균 6.8%로 성장하여 2024년에는 6조 9,107억 원의 시장규모를 형성할 것으로 전망된다.

그림 6&gt;&gt; 세계 반도체 장비 시장규모 및 국내 반도체 장비 시장규모

(단위: 억 달러/억 원)



자료: 국제반도체장비재료협회(2020), 중소기업 전략기술로드맵 보고서(2021~2023), NICE디앤비 재가공

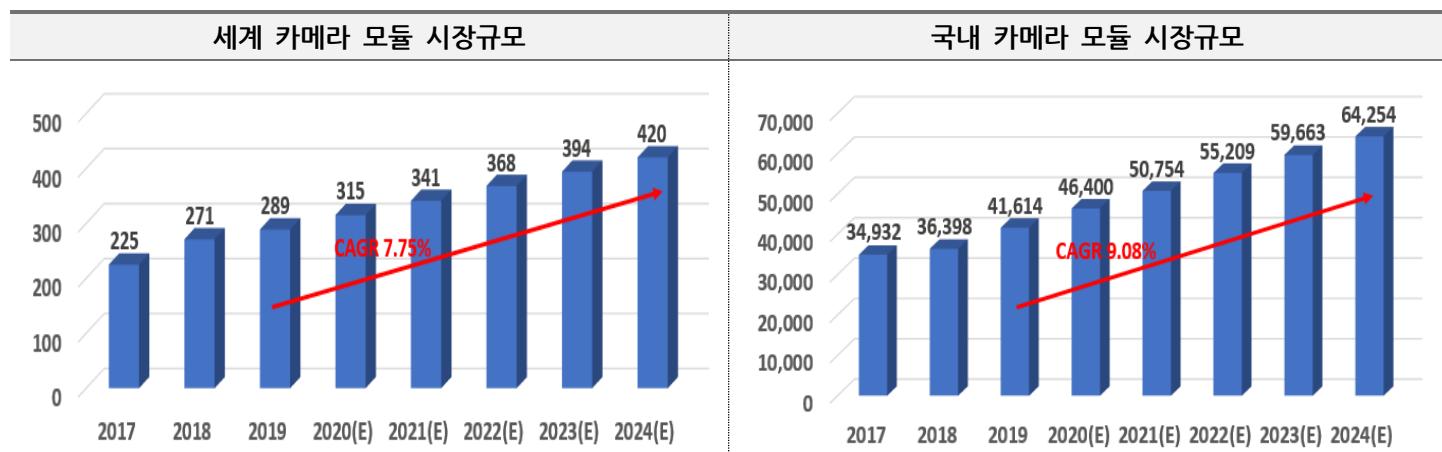
### 스마트폰의 고성능 경쟁으로 고화질 카메라 모듈 성장 전망

Market, Markets and Markets(2020)에 따르면, 세계 카메라 모듈 시장은 2017년 225억 달러에서 연평균 6.42% 성장하여 2019년 289억 달러 수준이며, 2019년 이후 연평균 7.75% 성장하여 2024년에는 420억 달러의 시장규모를 형성할 것으로 전망된다. 세계 카메라 모듈 시장은 스마트폰 구성 부품 내 카메라 모듈이 차지하는 가격 비중이 높아 지속적인 모듈 공급가 하락 압력이 작용하고 있으며, 대량 생산 체제를 갖춘 중국·대만 기업들과의 원가 경쟁이 심화되고 있다. 또한, 스마트폰의 고성능 경쟁으로 고화질 카메라 모듈에 대한 교체 수요와 차량용 카메라, 드론, 웨어러블 디바이스에서의 적용이 증가하고 있다.

또한, 국내 카메라 모듈 시장은 2017년 3조 4,932억 원에서 연평균 9.15% 성장하여 2019년 4조 1,614억 원 수준이며, 2019년 이후 연평균 9.08% 성장하여 2024년에는 6조 4,254억 원의 시장규모를 형성할 것으로 전망된다.

그림 7&gt;&gt; 세계 카메라 모듈 시장규모 및 국내 카메라 모듈 시장규모

(단위: 억 달러/억 원)



자료: Market, Markets and Markets(2020), NICE디앤비 재가공

## 최근 3개년 큰 폭의 외형 등락을 보이고 있으며, 2020년 LED, 반도체 장비 부문이 동사의 매출을 견인하며 일부 외형 회복

동사는 LED 장비, 반도체 장비, 카메라 모듈 장비 제조 전문업체이다. LED, 반도체, 카메라 모듈 장비 등 IT 산업의 장비사업은 주문자 생산 수주산업의 특성이 있어 수주상황에 따라 분기별, 연도별 실적 편차가 일반적인 제조업에 비해 크게 나타나는 특징을 보이고 있으며, 동사의 최근 3개년 매출 외형이 큰 등락을 보여왔다.

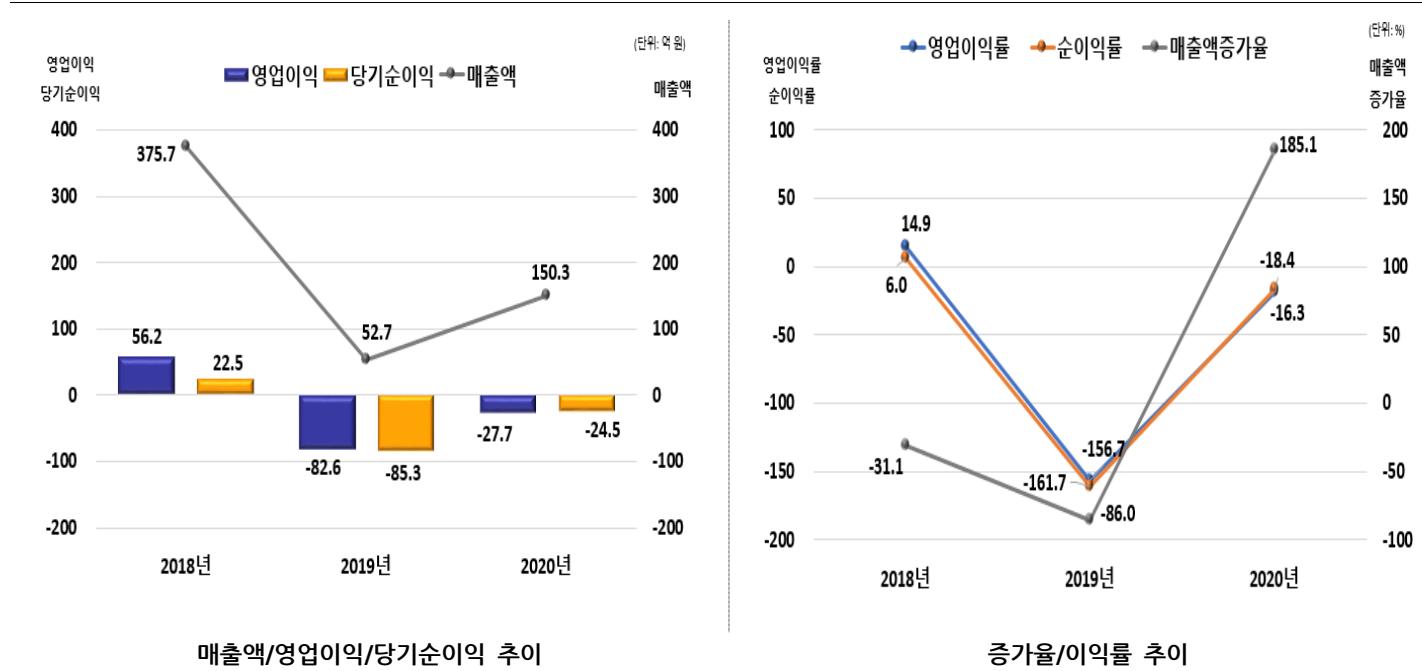
동사의 2020년 사업부문별 매출 비중을 살펴보면, Mini & Micro LED 장비 35.3%, 반도체 장비 35.0%, 카메라 모듈 장비 부문 13.6% 외 기타 16.1%로 구성되어 있으며, LED 와 반도체 장비 부문의 매출이 전년 대비 4배 이상 증가하면서 외형을 일부 회복하였다.

한편, 동사는 중국 등지로 수출을 병행하고 있으며, 2020년 전체 매출 내 내수와 수출 비중은 각각 80.5%와 19.5%로 국내 매출이 동사의 매출을 견인하고 있다.

2020년 연간 실적은 매출액 150.3억 원으로 2019년 52.7억 원 대비 185.1% 증가한 수치이나, 과거 매출액이 2017년은 545.2억 원, 2018년은 375.7억 원 등으로 예년 수준의 외형은 회복하지 못하고 있다. 2020년 LED 및 반도체 장비 등에 대한 수주 증가의 영향으로 일부 외형을 회복했으며, 동사는 재도약을 위해 Mini LED, Micro LED 장비 등을 개발하는데 역량을 집중하고 있다. 외형 회복에도 불구하고 Mini LED, Micro LED 등 관련한 연구개발비 외 판관비 부담으로 2020년 영업손실 27.7억 원, 당기순손실 24.5억 원을 기록하며 적자를 지속했으나, 2019년 손실[영업손실 82.6억 원, 순손실 85.3억 원] 대비 적자 폭이 크게 축소되었다..

**그림 8>> 동사 연간 및 2020년 반기 요약 포괄손익계산서 분석**

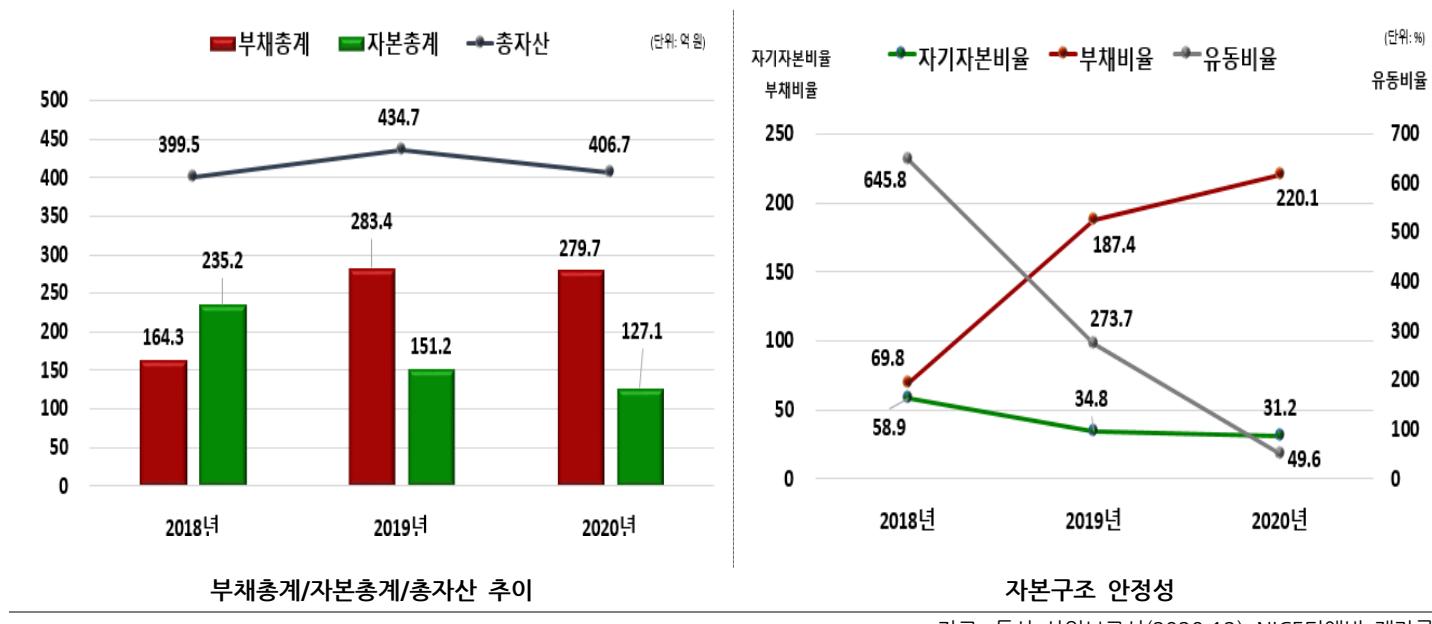
(단위: 억 원, %, K-IFRS 별도기준)



자료: 동사 사업보고서(2020.12), NICE디앤비 재가공

## 그림 9&gt;&gt; 동사 연간 및 2020년 반기 요약 재무상태표 분석

(단위: 억 원, %, K-IFRS 별도기준)

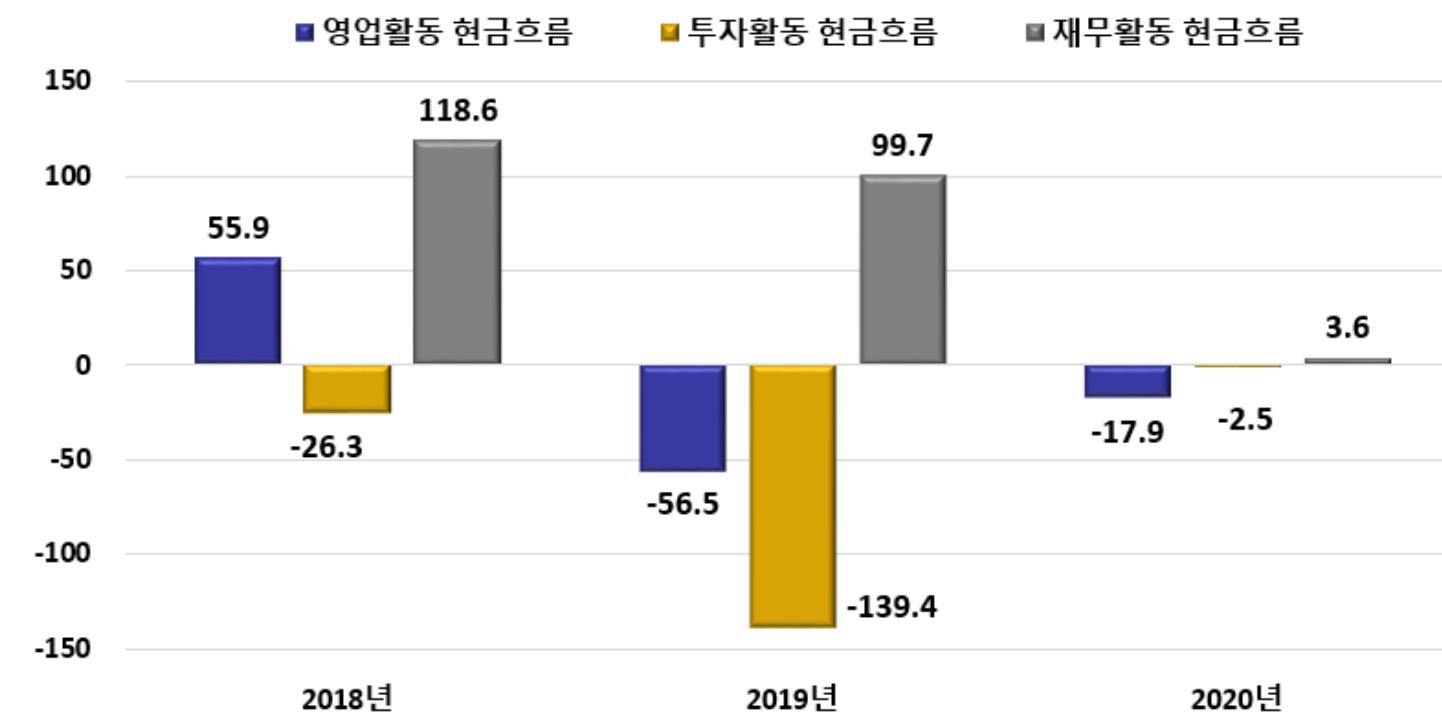


자료: 동사 사업보고서(2020.12), NICE디앤비 재가공

자기자본비율이 2019년 말 34.8%에서 2020년 말 31.2%로 소폭 하락했으며, 누적결손으로 자기자본 규모가 축소되어 부채비율이 2019년 말 187.4%에서 2020년 말 220.1%로 저하되는 모습을 보였다. 다만, 기말 일정 수준의 현금성 자산[66.9억 원 가량]을 보유하고 있으며, 상장사로써 외부차입을 통한 자금조달이 용이한 만큼 유동성 위험은 높지 않은 것으로 판단된다.

## 그림 10&gt;&gt; 동사 현금흐름의 변화

(단위: 억 원)



자료: 동사 사업보고서(2020.12), NICE디앤비 재가공

## [체크포인트]

- ✓ 동사는 2005년 4월 설립된 공인 기업부설연구소 내에 레이저/광학/생산기술 연구실을 운영하고 있으며, LED 장비, 카메라 모듈 장비, 반도체 장비의 다양한 제조 및 검사장비에 대한 제품 개발을 수행하며 신규 제품 라인업을 확보하고 있다. 세계 디스플레이 장비 시장이 침체되고 있으나, 동사는 신 성장 동력으로 Mini LED, Micro LED 등 차세대 디스플레이 장비 개발 본격화를 통해 침체된 디스플레이 장비 산업의 위기에서 새로운 성장 기회를 모색하고 있다.
- ✓ 동사는 LED, 반도체, 카메라 모듈 장비 등 IT산업의 장비사업은 주문자 생산 수주산업의 특성이 있어 수주상황에 따라 분기별, 연도별 실적 편차가 일반적인 제조업에 비해 크게 나타나는 특징을 보이고 있으며, 동사의 최근 3개년 매출 외형이 큰 등락을 보여왔다. 동사는 2020년 LED 및 반도체 장비 등에 대한 수주 증가의 영향으로 일부 외형을 회복했으며, 재도약을 위해 Mini LED, Micro LED 장비 등을 개발하는데 역량을 집중하고 있다.

## [용어설명]

- ✓ DPSS(Diode-pumped solid-state): 레이저다이오드를 광원으로 하여 고체 크리스탈에 빛을 쐬어 특정 색상의 빛으로 변화시키는 방식을 말한다.
- ✓ CCD(Charge Coupled Device) 이미지 센서: 빛을 전하로 변환시켜 화상을 얻어내는 센서를 말한다.
- ✓ CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 이미지 센서: 상보성 금속 산화막 반도체(CMOS)를 이용한 센서를 말한다.
- ✓ 로컬디밍(local dimming): 백라이트를 다수의 영역으로 구분, 휘도를 영상 신호와 연계해 영상의 어두운 부분에 해당되는 영역은 백라이트를 끄거나 빛을 줄이고, 밝은 영역은 휘도를 높여줌으로써 명암비 및 소비전력을 기존 LED 대비 개선한 기술을 말한다.

\* 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것입니다. 또한, 작성기관이 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서, 본 보고서를 활용한 어떤 의사결정에 대해서도 작성기관은 일체 책임을 지지 않습니다.